

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2023年3月9日(09.03.2023)



(10) 国際公開番号

WO 2023/032924 A1

(51) 国際特許分類:
H01L 21/312 (2006.01) C08G 73/10 (2006.01)

(21) 国際出願番号: PCT/JP2022/032439

(22) 国際出願日: 2022年8月29日(29.08.2022)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願 2021-144612 2021年9月6日(06.09.2021) JP

(71) 出願人: 三井化学株式会社 (MITSUI CHEMICALS, INC.) [JP/JP]; 〒1057122 東京都港区東新橋一丁目5番2号 Tokyo (JP).

(72) 発明者: 茅場 靖剛 (KAYABA, Yasuhisa); 〒2990265 千葉県袖ケ浦市長浦580-32 三井化学株式会社内 Chiba (JP). 中村 雄三 (NAKAMURA, Yuzo); 〒2990265 千葉県袖ケ浦市長浦580-32 三井化学株式会社内 Chiba (JP). 河関 孝志 (KOZEKI, Takashi); 〒2990265 千葉県袖ケ浦市長浦580-32 三井化学株式会社内 Chiba (JP).

(74) 代理人: 弁理士法人太陽国際特許事務所 (TAIYO, NAKAJIMA & KATO); 〒1600022 東京都新宿区新宿4丁目3番17号 Tokyo (JP).

(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT,

HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

一 国際調査報告 (条約第21条(3))

(54) Title: COMPOSITION FOR FORMING FILM FOR SEMICONDUCTOR, LAMINATE, AND SUBSTRATE LAMINATE

(54) 発明の名称: 半導体用の膜を形成するための組成物、積層体及び基板積層体

(57) Abstract: A composition for forming a film for a semiconductor, the composition comprising: an aliphatic diamine (A) which includes a main chain containing carbon atoms, and a primary amino group and a secondary amino group, and in which the total number of the primary and secondary amino groups is at least two, and the number of carbon atoms included in the main chain is 2-180; and a crosslinking agent (D) which has weight-average molecular weight of 200-2000, which includes, in the molecule, at least three -C(=O)OX groups (X represents a hydrogen atom or an alkyl group having 1-6 carbon atoms), and in which 1-6 of the at least three -C(=O)OX groups are a -C(=O)OH group. An application of the composition for forming a film for a semiconductor.

(57) 要約: 1級アミノ基及び2級アミノ基並びに炭素原子を含む主鎖を含み、1級アミノ基及び2級アミノ基の合計が2つ以上であり、前記主鎖を構成する炭素原子の数が2以上180以下である脂肪族ジアミン(A)と、分子内に-C(=O)OX基(Xは、水素原子又は炭素数1以上6以下のアルキル基である)を3つ以上含み、3つ以上の-C(=O)OX基のうち、1つ以上6つ以下が-C(=O)OH基であり、重量平均分子量が200以上2000以下である架橋剤(D)と、を含む、半導体用の膜を形成するための組成物及びその応用。

WO 2023/032924 A1